

ANALYSE DES RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA NORME ST.91 DE L'OMPI

*Résultats de l'enquête présentés à la douzième session
du Comité des normes de l'OMPI (CWS) le 19 septembre 2024*

INTRODUCTION

1. À sa onzième session tenue en décembre 2023, le Comité des normes de l'OMPI (CWS) a approuvé le questionnaire sur la mise en œuvre de la norme ST.91 de l'OMPI par les offices de propriété intellectuelle. Le CWS a prié le Secrétariat de diffuser une circulaire invitant les offices de propriété intellectuelle à répondre à cette enquête (voir le paragraphe 87 du document CWS/11/27).

RESULTATS DE L'ENQUETE

2. En mars 2024, le Secrétariat a diffusé la circulaire C.CWS 179, dans laquelle il invitait les offices de propriété intellectuelle à participer à l'enquête sur la mise en œuvre de la norme ST.91 de l'OMPI. L'enquête s'est déroulée de mars à avril 2024.

3. Les 22 membres du CWS ont pris part à l'enquête, à savoir les offices des États membres suivants – Allemagne (DE), Australie (AU), Bhoutan (BT), Bulgarie (BG), Canada (CA), Croatie (HR), Estonie (EE), Fédération de Russie (RU), Gambie (GM), Hongrie (HU), Italie (IT), Japon (JP), Lituanie (LT), Namibie (NA), République arabe syrienne (SY), République de Corée (KR), République tchèque (CZ), Royaume-Uni (GB) et Slovaquie (SK), ainsi que les offices régionaux suivants – Office eurasiatique des brevets (EA), Office européen des brevets (OEB) et l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EM). Les réponses individuelles des offices de propriété intellectuelle et la synthèse des résultats sont disponibles dans la [partie 7 du Manuel de l'OMPI](#).

ANALYSE DES RESULTATS DE L'ENQUETE

4. Parmi les réponses, 12 participants (55%) ont indiqué qu'ils n'utilisaient toujours pas de modèles 3D, d'images 3D ou de structures chimiques 3D; neuf (41%) ont indiqué qu'ils les utilisaient et un (5%) a fait part d'un cas d'utilisation particulier dans sa réponse.

5. Parmi les participants à l'enquête ayant répondu qu'ils utilisaient des modèles, des images ou des structures chimiques 3D dans leur pratique : 67% utilisent la 3D pour des dessins et modèles industriels, 56% l'utilisent pour des marques, 44% l'utilisent pour des brevets, 22% pour des modèles d'utilité et 22% pour d'autres droits de propriété intellectuelle.

6. Il est important de noter que parmi les offices ayant répondu, la majorité (64%) ne met pas en œuvre la norme ST.91 de l'OMPI alors que 27% la mettent en œuvre partiellement et 9% pour cent la mettent en œuvre pleinement.

7. En ce qui concerne l'utilisation des formats de fichier recommandés par la norme ST.91 de l'OMPI, pour les fichiers que les offices de propriété intellectuelle reçoivent actuellement :

Droits de propriété intellectuelle	Format de fichier le plus utilisé (dans l'ordre décroissant)
Marques	OBJ, STL, PDF 3D
Dessins et modèles industriels	PDF 3D, OBJ, STL, STEP
Brevets (y compris structures chimiques)	PDF 3D, STEP
Modèles d'utilité	PDF 3D

8. En ce qui concerne la publication des modèles 3D, images 3D ou structures chimiques 3D recommandée par la norme ST.91 de l'OMPI, les offices qui ont répondu ont indiqué que pour la plupart, ils ne publiaient pas les informations 3D reçues, même si la 3D était acceptée. Les formats les plus utilisés pour les marques sont OBJ et STL alors que le format le plus fréquemment utilisé pour la publication de dessins et modèles industriels, de brevets et de modèles d'utilité est le format PDF 3D. De même, pour ce qui est de la question concernant la publication sur papier de

données 3D, la plupart des offices ayant répondu ont indiqué ne pas publier les informations relatives aux modèles 3D, aux images 3D ou aux structures chimiques 3D sur papier, même s'ils les acceptent. Les offices de propriété intellectuelle qui publient des objets 3D sur papier publient des objets 3D déposés à l'aide de représentations en 2D générées à partir de modèles 3D ou d'images 3D sources pour tous les droits de propriété intellectuelle indiqués dans l'enquête.

9. Il est important de noter qu'aucun office de propriété intellectuelle n'utilise les formats 3D recommandés pour la topologie de circuit imprimé, que ce soit pour le dépôt ou pour la publication.

10. Au cours de l'examen, la majorité des offices ayant répondu indiquent utiliser des représentations en 2D aux fins de la comparaison des modèles 3D et des images 3D plutôt que les images ou modèles 3D eux-mêmes.

[Fin du document]